

2021年4月30日

各位

会社名	コマツ（株式会社 小松製作所）
代表者	代表取締役社長 小川 啓之 （コード番号 6301 東証第一部）
問合せ先	サステナビリティ推進本部 コーポレートコミュニケーション部長 山下 千津子（TEL. 03-5561-2616）

スマートコンストラクション事業の権利義務の一部の当社完全子会社への会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年7月1日（予定）を効力発生日として、会社分割（吸収分割）の方法により、株式会社ランドログ（以下「ランドログ」といいます）に対して、当社が有するスマートコンストラクション事業に関する権利義務の一部を承継させること（以下「本吸収分割」といい、本吸収分割に係る吸収分割契約を「本吸収分割契約」といいます。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本吸収分割は、当社の完全子会社を承継会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

I. 本吸収分割の背景目的等

当社は国内の建設業界が抱える深刻な労働力不足という課題を解決するソリューションサービス「スマートコンストラクション」を2015年2月にスタートさせ、これまで13,000以上の国内の現場に導入をしてまいりました（2021年3月末現在）。

そして、2017年10月に、当社はランドログを設立しました。ランドログでは、建設業の抱える労働力不足という課題の解決を加速させ、できるだけ早く、安全で、生産性の高い、未来の現場の実現を目指し、スマートコンストラクションのサービス基盤となるプラットフォームを、当社と同様に建設業の課題解決に取り組む多くのサービス事業者の方々へもオープンに利用いただけるように、オープンプラットフォーム「LANDLOG」を開設しました。

その後、当社は、2020年4月より、これまでの施工プロセスにおける部分的なデジタル化によるソリューションサービスから、施工プロセス全体においてデジタル技術を活用し大きな変革をもたらし、安全性、生産性、環境性の飛躍的な向上を実現することができる、「DX スマートコンストラクション」を、日本、北米、欧州、豪州にて順次導入を開始いたしました。DXスマ

ートコンストラクションは、オープンプラットフォーム「LANDLOG」と、それにつながる、建設現場のデジタル化を、安価に、高精度に、高速に、簡単に行うことができる、「スマートコンストラクションレトロフィットキット」をはじめとする4つのデバイス、施工プロセスにおけるオペレーションの最適化を実現する、8つのアプリで構成されています。

本吸収分割後、ランドログは社名を「株式会社 EARTHBRAIN」に変更、事業領域の拡大と経営体制を一新させ、これまでコマツが開発してきた「DX スマートコンストラクション」の更なる進化を加速させてまいります。世界中の建設現場において、デジタルトランスフォーメーションによる新たな価値創造を行い、「安全で、生産性の高い、スマートでクリーンな現場」の1日でも早い実現を目指してまいります。

なお、「株式会社 EARTHBRAIN」社については、株式会社 NTT ドコモ、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、及び株式会社野村総合研究所を引受先とする、第三者割当により新株発行を行い、4社での合併事業とする予定です。

II. 本吸収分割について

1. 本吸収分割の要旨

(1) 吸収分割の日程

取締役会決議日(当社)	2021年4月30日
取締役会決議日(ランドログ)	2021年4月30日
本吸収分割契約締結日	2021年5月11日(予定)
株主総会決議日(ランドログ)	2021年6月4日(予定)
本吸収分割の効力発生日	2021年7月1日(予定)

なお、本吸収分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社においては吸収分割契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 吸収分割の方式

当社を分割会社とし、ランドログを承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

(3) 吸収分割に係る割当ての内容

ランドログは、本吸収分割に際して、普通株式26,460株を発行し、その全てを当社に割当て交付いたします。

(4) 吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権の取扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債は発行しておりません。

(5) 吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

ランドログは、当社がスマートコンストラクション事業に関して有する権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割後においてランドログが負担すべき債務について、履行の見込みはあるものと判断しております。

2. 吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (2021年3月31日時点)	承継会社 (2021年4月30日時点)
商号	株式会社小松製作所	株式会社ランドログ
本店所在地	東京都港区赤坂二丁目3番6号	東京都港区芝大門二丁目11番8号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長(兼)CEO 小川 啓之	代表取締役社長 井川 甲作
事業内容	建設・鉱山機械、ユーティリティ(小型機械)、林業機械、産業機械等の製造、販売	建設生産プロセスに関する各種データ等の収集、編集及び蓄積等を行うプラットフォームの企画、開発、運用、及び事業化 建設生産プロセスに関する各種データ等の生成、解析及び蓄積等を行うデータ生成システムの企画、開発、運用及び事業化
資本金	71,322百万円	150百万円
設立年月日	1921年5月13日	2017年10月5日
発行済株式数	972,887,610株	10,000株
決算期	3月31日	3月31日

大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	9.15%	株式会社小松製作所	100%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.94%		
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店）	3.23%		
	JP MORGAN CHASE BANK 385632 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部）	2.90%		
	太陽生命保険株式会社	2.87%		

直前事業年度（2020年3月期）の財政状態及び経営成績

	2020年3月期（連結）	2020年3月期（単体）
純資産	1,856,225百万円	42百万円
総資産	3,653,686百万円	367百万円
1株当たり純資産	1,875.47円（注1）	4,233円
売上高	2,444,870百万円	394百万円
営業利益	250,707百万円	18百万円
経常利益	223,114百万円（注2）	△1百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	153,844百万円	△1百万円
1株当たり当期純利益	162.93円	△229円

（注1）本表では「1株当たり純資産」に替え、当社の連結財務諸表の「1株当たり株主資本」を記載しています。

（注2）当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して作成しているため、本表では「経常利益」に替え、連結損益計算書上の「税引前当期純利益」を記載しています。

3. 吸収分割する事業の概要

(1) 分割する部門の事業内容

当社が有するスマートコンストラクション事業に関する権利義務の一部

(2) 分割する部門の経営成績

分割する部門は、当社が有するスマートコンストラクション事業に関する権利義務の一部であり、開発途上段階にあるため当該部門の経営成績はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
項目	帳簿価格（億円）	項目	帳簿価格（億円）
流動資産	3.8	流動負債	—
固定資産	60	固定負債	—
合計	63.8	合計	—

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価格は、2021年3月31日現在の金額に基づく見込額であり、実際に分割される金額は上記と異なります。

4. 吸収分割後の分割会社の状況

分割会社である当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に本吸収分割による変更はありません。

5. 吸収分割後の承継会社の状況

承継会社であるランドログの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に本吸収分割による変更はありません。なお、ランドログは、2021年7月1日（予定）付で商号を「株式会社 EARTHBRAIN」に変更する予定です。

6. 今後の見通し

本吸収分割は、当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであるため、本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上